

CSBFB700KJ58-R1

生産中止

RoHS

REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
R1	330mmエンボステーピング	3000

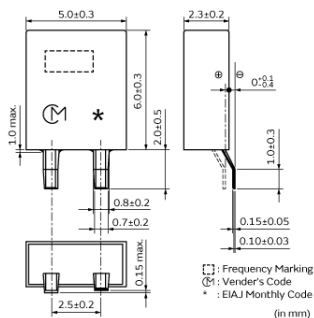
特長

リモコンセットの小型化および自動実装化、AV機器モジュール化等の進展と相まって、kHz帯のセラミック発振子でのリフロー対応が強く求められていましたが、パッケージング技術の改良によって、リフロー対応表面実装型セラミック発振子を実現しています。

■特長

1. リフローはんだ付けができます。
2. エンボステーピングによる自動装着が可能です。
3. 発振回路の無調整化ができます。

外観および形状



お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
- 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

CSBFB700KJ58-R1

スペック

製品タイプ	セラミック発振子(セラロック)
シリーズ名	CSBFB_J
周波数	700.0kHz
周波数許容偏差	±0.50%以内
使用温度範囲	-20℃~80℃
周波数温度特性	±0.30%以内
周波数エージング	±0.30%以内
共振抵抗 (R1)	40Ω以下
形状	SMD
洗浄	対応
LxW寸法	6.0x5.0mm
質量	115mg

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。